

วิทยานิพนธ์นี้ได้นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพในการตรวจสอบขอบและความสมบูรณ์ของบัม ในส่วนประกอบฟลิปชิปซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์บัม คือ จุดรอยบัดกรีทั้งในส่วนของเส้นวงจรและอุปกรณ์ในฟลิปชิป โดยทั่วไปการตรวจสอบบัมจะอาศัยกล้องเอ็กซเรย์ความละเอียดสูง คุณสมบัติของบัมที่จะตรวจสอบที่สำคัญ คือ ค่าทางกายภาพต่างๆ อาทิเช่น อัตราส่วนบัม การเชื่อมต่อและขนาดของบัม แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการตรวจสอบโดยมนุษย์นี้มักมีข้อเสีย คือ สิ้นเปลืองเวลาในการตรวจสอบ และมักเกิดความผิดพลาดจากคน เพื่อแก้ปัญหานี้ในวิทยานิพนธ์นี้จึงนำเสนอการประยุกต์ใช้การตรวจสอบแบบวิทัศน์ แนวคิดใหม่ที่น่าสนใจในวิทยานิพนธ์นี้ ได้แก่ การใช้หลักการเชิงพันธุกรรมในการออกแบบ 마스크ที่ใช้หาขอบบัมซึ่งทำให้ความถูกต้องมีมากขึ้น จากนั้นจึงใช้เทคนิคการหาคุณสมบัติที่สนใจ (feature extraction) ทำการหาค่าและประเมินความสมบูรณ์ของบัมแทนมนุษย์ ซึ่งผลการทดลองจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเทคนิคที่น่าสนใจในการตรวจสอบคุณสมบัติและขนาดความยาวของบัม ความเร็วในการตรวจสอบบัมของระบบที่นำเสนอจะเร็วกว่าระบบการตรวจสอบโดยมนุษย์

This thesis proposes the development of image processing technique for inspecting edge and perfection of bump in the Flip-Chip component, which is an important part in hard disk drive. Bump is the soldering joint in PCB trace and Flip-Chip component. Normally, the bump inspection is carried out by human by considering the high-resolution X-ray image. The physical properties such as bump's ratio, bump's area, interconnection and bump's size, are mostly utilized as the specification to be inspected. However, there are many drawbacks of the human inspection such as time consuming, human error and etc. To overcome these problems, this thesis proposes the development of visual inspection by using image processing for inspecting the bump. The new contribution used in the thesis is the development of modified edge detection mask using genetic algorithm. This improves the accuracy of the inspection system. Image feature extraction for determining the interesting features is then used to evaluate the properties of bump instead of human. Experimental results show the effectiveness of the proposed technique for inspecting the properties and major axis length of bump. Inspection time of the proposed technique is much faster than that of human operation.